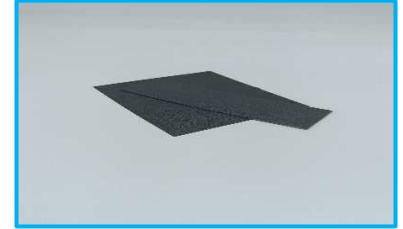


Nos Mousse Thermique appelés aussi Gap Pad ou Gap Filler sont des matériaux thermo conducteurs à base de silicone qui permettent de résoudre les problèmes de dissipation thermique. Le TEL_500_Z est un matelas spécialement développé pour des applications où un besoin de refroidissement faible est demandé. En effet, celui-ci est un excellent conducteur thermique de 50W/mK, avec une bonne résistance thermique facilitant ainsi le transfert de la chaleur et qui ne possède pas d'isolation électrique. Nous pouvons découper selon plan client. Tous nos matelas sont certifiés UL 94 en V0.

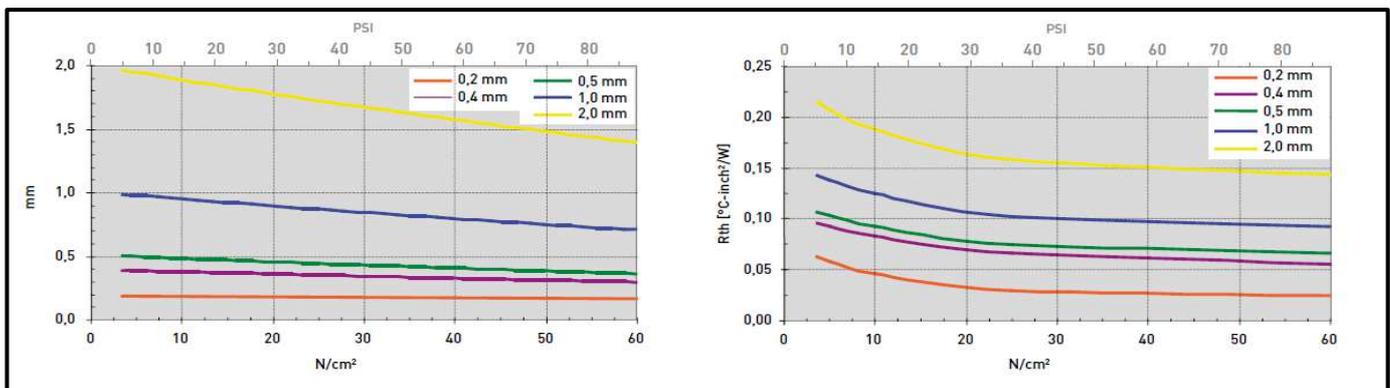


Domaines d'applications: Electronic components - Electric Vehicles, 5G, Autopilot System, Mobile Phone, AIOT, HPC (High Performance Computing), Server, IC, CPU, MOS, LED ,Mother Board, Power Supply, Heat Sink, LCD-TV, Notebook, PC, Telecom Device, Wireless Hub, DDR II Module, etc.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	Unit	TEL_500_Z			
		0.2	0.5	1	-
Epaisseur	mm	0.2	0.5	1	-
Renforcement	-	-			
Couleur	-	Noir			
Dureté	Shore 00	75			
Taille	mm	140*140			
Résistance @90 Psi	°C-inch ² /W (mm)	0.020 (0.16)	0.060 (0.33)	0.09 (0.70)	-
Résistance @30 Psi		0.027 (0.18)	0.075 (0.48)	0.11 (0.91)	-
Résistance @10Psi		0.050 (0.19)	0.095 (0.49)	0.13 (0.97)	-
Conductivité thermique	W/mK	50			
Température	°C	-50 to 180			
Tension de claquage	kV/mm	-			
Résistance volumique	Ohm - cm	< 50,000			
Contante dielectric	@1MHz	-			

Le TEL_500_Z est disponible en 0.2/0.4/0.5/1/1.5/2mm d'épaisseurs.



Les résultats ont été obtenus en conditions de laboratoire et doivent être considérés uniquement à titre indicatif. AB2E n'ayant aucun contrôle sur le matériel de ses clients et sur de nombreux autres facteurs, il relève de la responsabilité de l'utilisateur d'effectuer ses propres tests pour s'assurer que le produit correspond bien à ses besoins.